

**Bundesamt für Strahlenschutz**

**Bekanntmachung  
gemäß § 11 der Röntgenverordnung (RöV)  
2. Nachtrag zur Zulassung TH 01/01 Rö**

**Vom 20.Oktober 2005**

Gemäß den §§ 8 ff. RöV vom 8. Januar 1987 (BGBl. I S. 114) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 2003 (BGBl. I S. 604) wird die Bauartzulassung Nr. TH 01/01 Rö, erteilt vom Thüringer Landesverwaltungsamt Weimar am 14. Februar 2002, zuletzt geändert mit 1. Ergänzung vom Bundesamt für Strahlenschutz am 6. Mai 2003, wie folgt ergänzt:

Vorrichtung: Elektronenstrahlbelichtungsanlage

Bisherige Typen / Firmenbezeichnungen:

ZBA 350, ZBA 350 (DW), ZBA 350 (MW),  
ZBA 320-50 (DW), ZBA 320-50 (MW),  
SB 350 (DW), SB 350 (MW),  
SB 320-50 (DW), SB 320-50 (MW)

Inhaber der Zulassung /

Hersteller der Vorrichtung: Leica Microsystems Lithography GmbH  
Göschwitzer Straße 25  
07745 Jena

Die Bauartzulassung wird wie folgt geändert:

Die zulässigen Typen der Vorrichtungen werden um folgende Varianten ergänzt:

Typ der Vorrichtung	SB 351 DW	SB 350 C	SB 350 OS
Verwendungszweck	Wafer belichten (direct write)	Masken und Sondersubstrate belichten (cell projection)	Masken, Wafer und spezielle Substrate belichten, Gitterprojektions-Mode (optics special)

In diesem Rahmen werden zugelassene Referenz- und Austauschteile ergänzt.

Salzgitter, den 20.Oktober 2005  
57502/2-111

Bundesamt für Strahlenschutz

Im Auftrag  
C z a r w i n s k i